

적층제조 기술을 응용한 반도체 패키징 기술 심포지엄 계획(안)

< '23.04.20(목) 판교FAB 주하늘 주임, sky@3dpro.or.kr >

□ 개요

- (행사명) 적층제조 기술을 응용한 반도체 패키징 기술 심포지엄
- (일시) 2023년 5월 10일(수) 13시 30분
- (장소) 판교 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스 홀
- (주최) 3D프린팅연구조합
- (후원) 과학기술정보통신부
- (참석대상) 주최기관 관계자 및 업체 관계자 150명

□ 주요 내용

- 세미나 내용: 적층제조 기술을 이용한 반도체 패키징 기술의 발전 방향과 기술적 이슈 및 산업 응용 사례
 - 1) 반도체 산업의 현황과 전망
 - 2) 차세대 반도체 제조를 위한 나노기술과 적층제조 기술의 융합
 - 3) 적층제조기술을 응용한 반도체 공정장비 개발 현황과 전망
 - 4) PCB를 대체할 3D인쇄전자기술
- 장비 홍보
- 산학협력 네트워크 강화

□ 강연자 정보 및 세부 일정

○ 강연자

성명 및 소속/직급	이메일 및 연락처	분야
고종완 한국반도체산업협회 센터장	010-7333-5500	글로벌 반도체산업현황 및 정책동향
	jwko@ksia.or.kr	
유봉영 한양대학교 교수	010-7793-5508	Advanced Metallization for Packaging Technologies
	byyou@hanyang.ac.ke	
김성빈 애니캐스팅 대표이사	010-3896-5416	전기화학적 방법에 의한 3차원 인쇄전자 기술
	ksb@anycasting.com	

○ 강연 세부 일정

시 간	주요 내용	비 고
13:30~13:55	25' ○ 행사 등록 및 착석	
13:55~14:00	5' ○ 인사말 및 내외빈 소개	강민철 상임이사 (3D프린팅연구조합)
14:00~14:10	10' ○ 취임사	이조원 박사
14:10~14:20	10' ○ 축사	
14:20~14:30	10' 단체사진 촬영	
14:30~15:10	40' ○ 강연1. 글로벌 반도체산업현황 및 정책동향	고종완 센터장 (한국반도체산업협회)
15:10~15:50	40' ○ 강연2. 전기화학 3D 적층기술 활용한 전력반도체 패키징 공정 응용	김성빈 대표이사 (애니캐스팅)
15:50~16:20	30' 휴식	
16:20~11:00	40' ○ 강연3. 이종집적을 중심으로 한 첨단패키징 연구동향	유봉영 교수 (한양대학교)
17:00~	20' 패널 토론	

이조원박사 제4대 이사장 취임기념 적층제조 기술을 응용한 반도체 패키징 기술 심포지엄

일시_ 2023.05.10 (수) 13:30 - 17:00

장소_ 판교 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스 홀
(경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20)

주최_ 3D프린팅연구조합

심포지엄 일정

시간	내용 및 발표자
13:30 - 13:55	행사 등록 및 착석
13:55 - 14:00	인사말 및 내·외빈 소개
14:00 - 14:10	취임사 (이조원 박사)
14:10 - 14:20	축사
14:20 - 14:30	단체사진 촬영
14:30 - 15:10	글로벌 반도체산업현황 및 정책동향 고종완 한국반도체산업협회 센터장
15:10 - 15:50	전기화학 3D 적층기술을 활용한 전력반도체 패키징 공정응용 김성빈 애니캐스팅 대표이사
15:50 - 16:20	휴식
16:20 - 17:00	이종집적을 중심으로 한 첨단패키징 연구동향 유봉영 한양대학교 교수
17:00 -	패널 토론

사전등록

2023.04.18(수) ~ 05.09(수)

<https://forms.gle/5GGwK6HJY7hGuiqc8>



참가비 무료

주 차

3시간 무료주차 가능

문의사항

주하늘 주임연구원

sky@3dpro.or.kr / 031-5171-5911